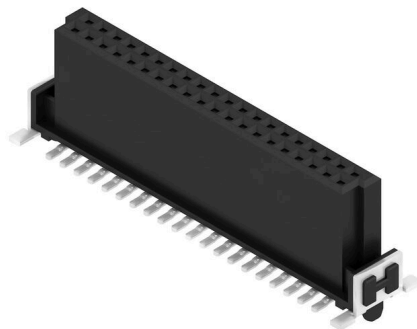


제품 이미지



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27 mm, 극 수: 40, 180°, Tape |
| 주문 번호      | <a href="#">2747390000</a>                                              |
| 유형         | FFH9 S1/40V F1 B RL                                                     |
| GTIN (EAN) | 4064675000761                                                           |
| 수량         | 280 items                                                               |
| 제품 데이터     | IEC: / 2.8 A<br>UL: 150 V                                               |
| 패키징        | Tape                                                                    |

FFH9 S1/40V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cURus)          | E92202                  |

치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이  | 7.8 mm   | 깊이 (인치) | 0.3071 inch |
| 높이  | 9.9 mm   | 높이 (인치) | 0.3898 inch |
| 너비  | 30.48 mm | 폭 (인치)  | 1.2 inch    |
| 순중량 | 6.26 g   |         |             |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 사양

|               |              |             |                       |
|---------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 전송 속도         | 3.125 Gbit/s | 제품군         | OMNIMATE 신호 - 보드 투 보드 |
| 결선 유형         | 보드 결선        | PCB에 장착     | SMD 용접 결선             |
| 피치(mm)(P)     | 1.27 mm      | 피치(인치)(P)   | 0.050 "               |
| 외향 앵글         | 180°         | 극 수         | 40                    |
| 플랫 용접 핀 수     | 1            | 공면:         | 0.1 mm                |
| 행 수           | 1            | 핀 시리즈 수량    | 2                     |
| 보호 등급         | IP20         | 볼륨 저항       | <25 mΩ                |
| 플러그 주기        | 500          | 플러깅 힘/폴, 최대 | 0.6 N                 |
| 당기는 힘 / 폴, 최대 | 0.6 N        |             |                       |

자재 데이터

|                |                                          |                      |         |
|----------------|------------------------------------------|----------------------|---------|
| 절연재            | LCP                                      | 컬러 코드                | 검정      |
| 컬러 차트(유사)      | RAL 9011                                 | 절연재 그룹               | IIIa    |
| 절연 저항          | ≥ 10 <sup>10</sup> Ω                     | Moisture Level (MSL) | 1       |
| UL 94 가연성 등급   | V-0                                      | 접점 기본 재질             | 구리 합금   |
| 접점 재질          | 구리 합금                                    | 접점 표면                | 금 도금 니켈 |
| 플러그 접점의 레이어 구조 | ≥ 2 μm Ni / ≥ 0.4 μm PdNi / ≥ 0.05 μm Au | 보관 온도, 최소            | -40 °C  |
| 보관 온도, 최대      | 70 °C                                    | 작동 온도, 최소            | -55 °C  |
| 작동 온도, 최대      | 125 °C                                   |                      |         |

IEC 정격데이터

|                     |        |         |        |
|---------------------|--------|---------|--------|
| 정격 전류, 극 수(Tu=20°C) | 2.8 A  | 연면거리, 분 | 0.4 mm |
| 최소간격, 분             | 0.4 mm |         |        |

UL 1977에 따른 정격 데이터

|        |                        |                    |       |
|--------|------------------------|--------------------|-------|
| 승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 | 정격 전압(UL 1977)(구형) | 150 V |
|--------|------------------------|--------------------|-------|

기술 데이터

패키징

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 패키징   | Tape      | VPE 길이 | 350.00 mm |
| VPE 폭 | 345.00 mm | VPE 높이 | 135.00 mm |

중요 참고 사항

|        |                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

참고 사항

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

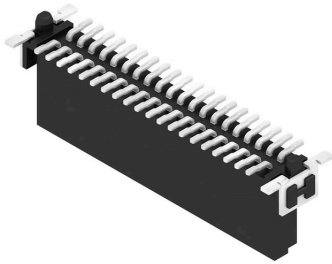
FFH9 S1/40V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

도면

제품 이미지



Dimensional drawing

| Type                | Order no.  | No. of poles | A     | B      | C     | D     | E     | G     |
|---------------------|------------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| FFH9 S1/27V F1 B RL | 2347140000 | 12           | 45.26 | 102.11 | 112.2 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |
| FFH9 S1/30V F1 B RL | 2347260000 | 18           | 6.89  | 112.1  | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |
| FFH9 S1/30V F1 B RL | 2347300000 | 24           | 11.43 | 112.1  | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |
| FFH9 S1/30V F1 B RL | 2347330000 | 30           | 16.26 | 112.1  | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |
| FFH9 S1/30V F1 B RL | 2347360000 | 36           | 21.10 | 112.1  | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |
| FFH9 S1/30V F1 B RL | 2347390000 | 42           | 25.94 | 112.1  | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |
| FFH9 S1/30V F1 B RL | 2347420000 | 48           | 30.78 | 112.1  | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |
| FFH9 S1/30V F1 B RL | 2347450000 | 54           | 35.62 | 112.1  | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |
| FFH9 S1/30V F1 B RL | 2347480000 | 60           | 40.46 | 112.1  | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |
| FFH9 S1/30V F1 B RL | 2347510000 | 66           | 45.30 | 112.1  | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |
| FFH9 S1/30V F1 B RL | 2347540000 | 72           | 50.14 | 112.1  | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |
| FFH9 S1/30V F1 B RL | 2347570000 | 78           | 54.98 | 112.1  | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |
| FFH9 S1/30V F1 B RL | 2347600000 | 84           | 59.82 | 112.1  | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 14.46 |

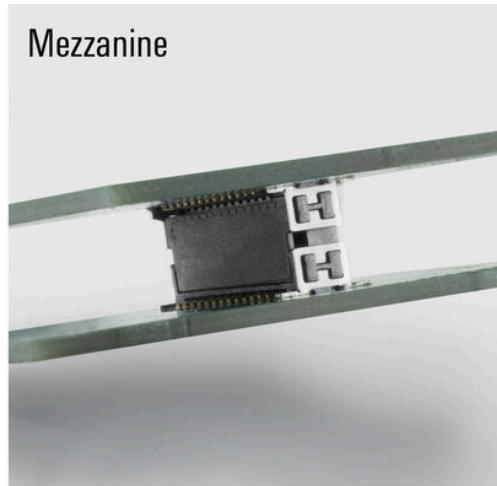
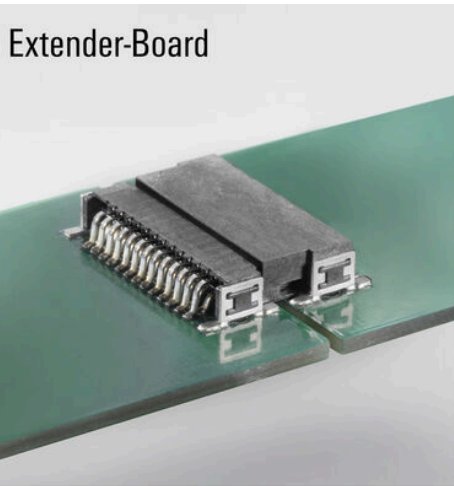


상세 도면



감소 곡선





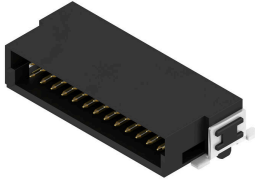
**FFH9 S1/40V F1 B RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

**FMH - 수형 헤더, 보드 결선**



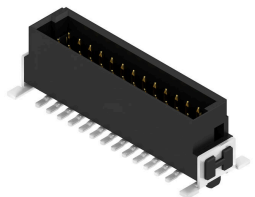
OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
 컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
 미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
 최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고점점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |                                                 |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 유형         | FMH S1/40V F1 B RL         | 버전                                              |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2747210000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27 |  |
| GTIN (EAN) | 4064675001034              | mm, 극 수: 40, 90°, Tape                          |  |
| 수량         | 560 ST                     |                                                 |  |

**FMH1 - 수형 헤더, 보드 결선(스택 높이 1.75mm)**



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
 컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
 미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
 효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
 그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
 투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
 최대한의 유연성을 제공합니다.

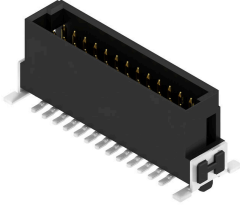
- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고점점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |                                                 |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 유형         | FMH1 S1/40V F1 B RL        | 버전                                              |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2747030000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27 |  |
| GTIN (EAN) | 4064675001485              | mm, 극 수: 40, 180°, Tape                         |  |
| 수량         | 280 ST                     |                                                 |  |

대응물

FMH3 - 수형 헤더, 보드 결선(스택 높이 3.25mm)



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 폴까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

|            |                            |                                                 |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 유형         | FMH3 S1/40V F1 B RL        | 버전                                              |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2747120000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, SMD 용접 결선, 피치(mm)(P): 1.27 |  |
| GTIN (EAN) | 4064675001164              | mm, 극 수: 40, 180°, Tape                         |  |
| 수량         | 280 ST                     |                                                 |  |